

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-105320
(43)Date of publication of application : 09.04.2003

(51)Int.Cl.

C09K 3/10
C08F290/06
F16J 15/14

(21) Application number : 2001-301308

(22) Date of filing : 28.09.2001

(71)Applicant : NIPPON MEKTRON LTD

(72)Inventor : WATANABE TETSUYA
YOKOYAMA TAKASHI

(54) LIQUID GASKET MATERIAL FOR PRECISION INSTRUMENT AND METHOD FOR PRODUCING GASKET FOR PRECISION INSTRUMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a gasket for precision instruments, realizing sufficient sealing properties and producible at a high productivity by using an X-Y-Z axes coating robot.

SOLUTION: The gasket is obtained by discharging a liquid gasket material on the surface of a substrate in stringy state with an X-Y-Z axes coating robot, curing the liquid gasket material by irradiating it with an active energy ray to obtain the gasket, wherein fluidity of the gasket material increases in dynamic state, that is, when stress is applied, but high viscosity is kept in static state, in other word, the material has extremely high thixotropy. Thereby, the liquid gasket material is effectively discharged on the surface of the substrate from the nozzle of the X-Y-Z axes coating robot at a high productivity to keep the ideal form the cross section of the discharged liquid gasket material and so as the gasket having sufficient sealing activity is produced at a high productivity.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-105320

(P2003-105320A)

(43)公開日 平成15年4月9日(2003.4.9)

(51) Int.Cl.'

識別記号

FI
C09K 3/10

テ-7コ-ト(参考)
4H017
4J027

C 08 F 290/06

C 0 8 E 290/06

審査請求 未請求 請求項の数4 QL (全8頁) 最終頁に統べ

(21) 出願番号 特願2001-301308(P2001-301308)

(71) 出願人 000230249

(22)出願日 平成13年9月28日(2001.9.28)

日本メクトロン株式会社
東京都港区赤坂1丁目10番15号

(72)発明者 渡辺哲也
茨城県北茨城市磯原町上相田831-2 日
本メクトロン株式会社ケミテック事業部内

(72) 発明者 横山 隆
茨城県北茨城市磯原町上相田831-2 日
本メクトロン株式会社ケミテック事業部内

(74) 代理人 100075812

弁理士 吉武 實次 (外5名)

最終頁に控ぐ

(54) 【発明の名称】精密機器用液状ガスケット材料およびそれを用いた精密機器用ガスケットの製造方法

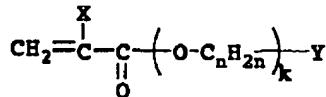
(57)【要約】

【課題】 充分なシール性能を発揮し、かつX-Y-Z軸塗布ロボットを用いて高い生産性で製造可能な精密機器用ガスケットの製造方法を提供する。

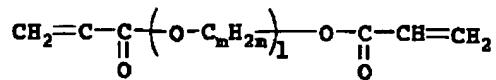
【解決手段】 応力を加えた動的な状態では流動性が増加するが静的な状態においては高い粘度を維持する、いわゆるチクソトロピー性が極めて高い液状ガスケット材料を、X-Y-Z軸塗布ロボットのノズルから精密機器の防塵カバーである基板表面上に紐状に吐出した後、吐出した液状ガスケット材料に活性エネルギー線を照射して硬化させガスケットを得る。これにより、X-Y-Z軸塗布ロボットのノズルから液状ガスケット材料を効率良く高い生産性で基板表面に液状ガスケット材料を吐出しつつ、吐出した液状ガスケット材料の断面形状を理想的な断面形状に保持することができるから、充分なシール性能を有するガスケットを高い生産性で製造することができる。

【特許請求の範囲】

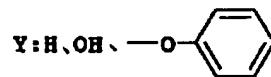
【請求項1】活性エネルギー線の照射により硬化する精密機器用液状ガスケット材料であって、(A)イソシアネート基を1分子中に2つ以上もつポリウレタンオリゴマーと水酸基を有する(メタ)アクリレートエステルからなる分子量5,000~100,000のウレタンア*



…一般式1



…一般式2

但し、X:H、CH₃

n=2~12、k=1~6

1=2~14、m=2~4

(C)光重合開始剤を0.1~5重量部と、を含むことを特徴とする精密機器用ガスケット材料。

【請求項2】高チキソトロピー性を附加させる無機充填剤をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載した精密機器用液状ガスケット材料。

【請求項3】請求項1または2に記載の精密機器用液状ガスケット材料をX-Y-Z軸塗布ロボットのノズルから基板表面の所定位置に吐出した後、吐出した前記精密機器用液状ガスケット材料に活性エネルギー線を照射して硬化させることにより精密機器用ガスケットを得る、ことを特徴とする精密機器用ガスケットの製造方法。

【請求項4】硬化させて得た前記精密機器用ガスケットを高温処理することを特徴とする請求項3に記載した精密機器用ガスケットの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は紫外線等の活性エネルギー線を照射すると硬化する精密機器用液状ガスケット材料、およびそれを用いた精密機器用ガスケットの製造方法に関し、より詳しくは、低硬度で残留ひずみが小さく、かつ揮発ガス量が微量となるように改良された精密機器用ガスケットの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、電子計算機、携帯電話、デジタルカメラ等の電子機材の小型化が進み、それらに用いられる小型部品も急速に精密化が求められている。その中でも電子計算機に内蔵される記憶装置であるハードディスクドライブ(以下、HDDと表す)の高性能化は特に著しい。

【0003】HDDにおいては磁気ディスクとヘッド、モータおよびそれらに関連する電子部品が外部からの異物によって汚染されないように、それらを完全に密閉す

*クリレートオリゴマーを100重量部と、(B)下記の一般式(1)若しくは一般式(2)で示されるアクリレートモノマー、およびそれらの混合物を30~300重量部と、

【化1】

…一般式1

…一般式2

n=2~12、k=1~6

1=2~14、m=2~4

る構造となっている。このため一般的にHDD本体容器と防塵カバーとの間に介装されるガスケットとして高分子弹性体が使用されている。

【0004】一方、パソコンの高性能化および小型化という時代背景のもと、HDDは更なる記憶容量の増大が求められている。このため、HDDの磁気ディスクとヘッドとの隙間は、より一層狭くなる傾向にある。

【0005】他方、HDDの磁気ディスクとヘッドとの隙間の狭小化が進むに連れ、HDDを構成する部品から発生する揮発性成分が磁気ディスクを汚染し、記憶障害を起こすことが知られており、現在これが重要な問題となっている。高分子弹性体を使用するガスケット自身から揮発するガスもまた例外ではなく、揮発ガスの発生量を抑えたガスケットが切望されている。

【0006】このような問題点を解決するべく、特再平8-810594号公報に記載されたガスケットの製造方法においては、紫外線硬化性を有する液状材料をX-Y-Z軸塗布ロボットを用いて基板上に吐出した後に紫外線を照射することにより、簡便かつ化学的に安定で、さらには正確な形状のガスケットを製造するようになっている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、揮発成分量が数ppmレベルを求められている近年の精密機器用ガスケットの製造法としては、上述したガスケットの製造方法によっても未解決な部分が多い。

【0008】また、ガスケットのシール性能を充分に発揮させるためには、変形に対する抵抗力が小さい、つまり低硬度で残留ひずみの小さい高分子弹性体が有効であり、かつ締付け時のつぶし代も大きくする必要があり、そのためにはガスケットの断面高さを大きくすることが不可欠となる。このような断面高さの大きい形状のガスケットをX-Y-Z軸塗布ロボットを用いて製造する際

には、できるだけ高粘度の材料を使用する方が有利である。しかしながら、高粘度材料を使用した場合、塗布装置の吐出能力を低下させて生産性が落ちるといったデメリットも生じる。

【0009】そこで本発明の目的は、例えばHDDのようにガスケットから揮発するガス量が極めて低レベルであることが必要とされる精密電子機器に使用が可能であり、かつ充分なシール性能を発揮し、さらにはX-Y-Z軸塗布ロボットを用いて高い生産性で製造可能な精密機器用ガスケットの製造方法を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決する本発明は、液体状態ではチキソトロピー性が高く、活性エネルギー線の照射により硬化した後には精密機器用ガスケットとして最適な低硬度性および低残留ひずみ性を示す精密機器用液状ガスケット材料を提供する。そして、この精密機器用液状ガスケット材料をX-Y-Z軸塗布ロボットを用いて精密機器の防塵カバーである基板上の所定位置に塗布した後、活性エネルギー線を照射して硬化させることにより精密機器用ガスケットを得る。

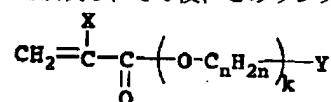
【0011】本発明で使用する精密機器用液状ガスケット材料は下記(A)～(C)の成分を含み、紫外線等の活性エネルギー線を照射することで容易に硬化する。

(A) イソシアネート基を1分子中に2つ以上もつポリウレタンオリゴマーと水酸基を有する(メタ)アクリレートエステルからなる分子量5,000～100,000のウレタンアクリレートオリゴマー、100重量部。

(B) 一般式1若しくは一般式2で示されるアクリレートモノマー、およびそれらの混合物、30～300重量部。

(C) 光重合開始剤、0.1～5重量部。

【0012】(A)成分のウレタンアクリレートオリゴマーは、まず分子量1,000～3,000のポリオールとジイソシアネート化合物、および多価アルコールとを重合反応させ分子鎖末端がイソシアネート基となるようなウレタンオリゴマーを調製し、その後、このウレタ*



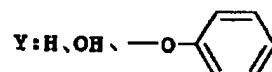
…一般式1



…一般式2

但し、X: H、CH₃

n=2～12、k=1～6



l=2～14、m=2～4

【0018】また、液状ガスケット材料を硬化させる手段として紫外線照射を使用する場合には、(C)成分として光重合開始剤を添加する必要がある。光重合開始剤

の種類は、ベンゾインエーテル、ベンジルジメチルケタール、α-ヒドロキシアルキルフェノン、α-アミノアルキルフェノン等が挙げられ、必要に応じて1種類、若

しくは2種類以上の混合物として使用する。

【0019】活性エネルギー線を用いて液状ガスケット材料を硬化させることにより製造したガスケットは、基板との接着力を増加させるため、およびガスケットに含まれる揮発性成分を除去するために高温処理を行う。

【0020】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る精密機器用ガスケットの製造方法の一実施形態を、図1乃至図6を参照して詳細に説明する。ここで、図1は本発明に係る精密機器用ガスケットの製造方法に用いるX-Y-Z軸塗布ロボットの概略正面図、図2は図1に示したX-Y-Z軸塗布ロボットの概略側面図、図3は図1および図2に示したX-Y-Z軸塗布ロボットを用いて基板表面上に液状ガスケット材料を塗布する状態を示す概略側面図、図4は基板表面上に吐出した液状ガスケット材料の配置を説明する概略斜視図、図5は基板表面上に製造したガスケットの断面図、図6は実施例の結果を示す表図である。

【0021】本発明に係る精密機器用ガスケットの製造方法においては、図1および図2に示す様なX-Y-Z軸塗布ロボットを用いて、上述した精密機器用液状ガスケット材料を金属基板の表面上に紐状に吐出す。このX-Y-Z軸塗布ロボット1は、X-Y-Z軸、すなわち前後左右上下の3次元方向に案内されて駆動されるディスペンサ2を有している。そして、このディスペンサ2にパイプ3を介して高圧空気を供給するとともに、ディスペンサ2の下端に設けたノズル4から水平テーブル5上に載置した金属基板6の表面の所定位置に光硬化型液状ガスケット材料を吐出す。これにより、金属基板6の表面上には、図3および図4に示したように光硬化型液状ガスケット材料7を連続的に切れ目無く吐出することができる。

【0022】X-Y-Z軸塗布ロボット1は、予めプログラムされたガスケット形状の描画パターンにしたがって金属基板6の表面上に液状ガスケット材料7を吐出す。このときの描画スピードは、液状ガスケット材料7の吐出の容易さ、すなわち液状ガスケット材料のチキソトロビー性に大きく依存する。

【0023】X-Y-Z軸塗布ロボット1を用いて金属基板6の表面上に吐出した液状ガスケット材料7には、紫外線や電子線等の活性エネルギー線を照射し、吐出した液状ガスケット材料7を硬化させる。これにより、金属基板6の表面上に、図5に示したような断面形状を有するガスケット8を製造することができる。

【0024】金属基板6の表面上に製造したガスケット8を圧縮する荷重が低い場合でも、充分なシール性能を得られるガスケット8の形状とは、図5に示す様に長方形と半円形とを組み合わせたような形状である。そして、ガスケット8の高さHと幅Wとの比の値はできるだけ大きい方が良いが、好ましい値は使用する液状ガスケ

ット材料の性質によりほぼ一定の値を示し、0.6～1.0の値が理想的である。

【0025】しかしながら、金属基板6の表面上に吐出する液状ガスケット材料7の粘度が低すぎると液状ガスケット材料7の流動性が高いため、活性エネルギー線を照射して液状ガスケット材料7を硬化させる前に断面形状が変化し始め、その断面形状を図5に示した理想的な形状に止めておくことができない。これに対して、金属基板6の表面上に吐出する液状ガスケット材料7の粘度が高すぎると、液状ガスケット材料をノズル4から吐出する際の吐出抵抗が増加するため、X-Y-Z軸塗布ロボット1を用いたガスケット8の製造効率が大幅に低下してしまう。

【0026】本発明の様に液状ガスケット材料を塗布ロボットを用いて吐出し、さらに吐出形状と生産効率の両者をより良い状態にするためには、上記に示す様な光硬化型液状ガスケット材料に無機充填剤等の増粘剤を添加し高チキソトロビー性を付加させる必要がある。この様な高チキソトロビー性を付加させた光硬化型液状ガスケット材料の室温(25°C)における粘度は、回転粘度計を用いて測定した場合に、毎分20回転(20 rpm)のとき10,000～150,000 mPa·s、毎分2回転(2 rpm)のとき100,000～1,500,000 mPa·sが理想的である。

【0027】この様なチキソトロビー性が極めて高い液状ガスケット材料7を用いると、ノズル4から液状ガスケット材料7が吐出されるとき、圧力(応力)が加えられることにより流動性が高くなり、X-Y-Z軸塗布ロボット1を用いて効率良く金属基板6の表面上に液状ガスケット材料を吐出することができる。しかしながら金属基板6の表面上に吐出された後には負荷された圧力(応力)から開放され液状ガスケット材料7の流動性は低下し、ガスケットとしての高く盛り上がった理想的な断面形状を保持することができる。

【0028】X-Y-Z軸塗布ロボット1により金属基板6上に塗布された液状ガスケット材料7は、紫外線、電子線を発生する光照射装置を用いて直ちに硬化させる。完全な硬化が可能であればこの硬化反応は空気雰囲気下でも特に問題はないが、気相表面の硬化性(タック性)、アウトガス性を考慮すると、酸素の存在しない窒素ガス雰囲気下、または真空状態での照射が理想的である。

【0029】金属基板6の表面に加工したガスケット8は、金属基板6との接着力を増加させるため、およびガスケット8に含まれる揮発性成分を除去するために高温処理を行う必要がある。高温処理は80～180°Cの恒温槽内で3～24時間程度実施し、使用する恒温槽は風速0.5～1.0 m/秒程度で槽内の空気が1時間に10回以上の割合で入れ替わるもののが望ましい。また槽内を10 torr以下の真空状態に保つことが可能である

ならば、ガスケットの揮発性成分の除去には更に有効である。

【0030】

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何等限定されるものではない。

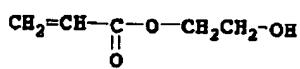
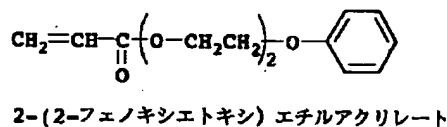
【0031】「光硬化型液状ガスケット材料Aの調製」攪拌装置、冷却器、温度計を備えた四つ口フラスコに3-メチル-1, 5-ベンタンジオールとアジビン酸からなるポリエステルポリオール（平均分子量2000）100.0重量部と2-(2-フェノキシエトキシ)エチルアクリレート120.5重量部を仕込み、80°Cまで加熱した。その後、4, 4'-ジフェニルメタンジソシアネート20.3重量部を加え、80~100°Cで60分間ウレタン化反応を行った。次いで、トリメチロールプロパンの変性物である3価ポリエーテルポリオール（分子量400）を5.0重量部加え、さらに80~100°Cで60分間ウレタン化反応をさせ、ポリウレタンオリゴマーのイソボルニルアクリレート溶液を得た。さらに、このポリウレタンオリゴマーのアクリレート溶液に2-ヒドロキシエチルアクリレート5.5重量部、トリエチレンジアミン0.0256重量部、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン2.6重量部、ヒンダードフェノール系酸化防止剤（IRGANOX 1010；チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）2.6重量部を加え、80~100°Cで90分間、ポリウレタンオリゴマーの末端アクリレート化反応を実施し、光硬化型液状ガスケット材料Aを得た。

*得た。

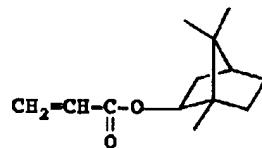
【0032】「光硬化型液状ガスケット材料Bの調製」攪拌装置、冷却器、温度計を備えた四つ口フラスコに3-メチル-1, 5-ベンタンジオールとアジビン酸からなるポリエステルポリオール（平均分子量2000）100.0重量部とイソボルニルアクリレート120.5重量部を仕込み、80°Cまで加熱した。その後、4, 4'-ジフェニルメタンジソシアネート20.3重量部を加え、80~100°Cで60分間ウレタン化反応を行った。次いで、トリメチロールプロパンの変性物である3価ポリエーテルポリオール（分子量400）を5.0重量部加え、さらに80~100°Cで60分間ウレタン化反応をさせ、ポリウレタンオリゴマーのイソボルニルアクリレート溶液を得た。さらに、このポリウレタンオリゴマーのアクリレート溶液に2-ヒドロキシエチルアクリレート5.5重量部、トリエチレンジアミン0.0256重量部、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン2.6重量部、ヒンダードフェノール系酸化防止剤（IRGANOX 1010；チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）2.6重量部を加え、80~100°Cで90分間、ポリウレタンオリゴマーの末端アクリレート化反応を実施し、光硬化型液状ガスケット材料Bを得た。

【0033】なお、2-(2-フェノキシエトキシ)エチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、およびイソボルニルアクリレートの化学式を下記に示す。

【化3】



2-ヒドロキシエチルアクリレート



【0034】

【実施例】「無機充填剤の混練」上述のように調製して得られた光硬化型液状ガスケット材料Aに親水性シリカ（1次粒子径：約12nm）を5wt%となるように添加して攪拌混合した後、三本ロールミルで3回混練してシリカを分散させた。

【0035】「試験用ガスケットの成形」X-Y-Z軸塗布ロボット1を用いて上記のように増粘させた光硬化型液状ガスケット材料を脱脂済みの無電解ニッケルメッキアルミ製HDD防塵カバー（70×100×0.4mm）上に図4に示す描画パターンで塗布した。その後、空気雰囲気下で6,000mJ/cm²の照射量で紫外線を照射して液状ガスケット材料7を硬化させた。

【0036】「試験用シートの成形」上述のように増粘させた光硬化型液状ガスケット材料をガラス製の型（20×100×2mm）内に流し込み、その後空気雰囲気下で6,000mJ/cm²の照射量で紫外線を照射して液状ガスケット材料7を硬化させた。

【0037】「高温熱処理」上述のように成形した試験用ガスケットおよびシートを160°Cの恒温槽内で7時間、高温熱処理を実施した。

【0038】「比較例1」上述のように調製して得られた光硬化型液状ガスケット材料Aに無機充填剤を添加せず、そのままの粘度で「試験用ガスケットおよび試験用シート」を成形し、高温熱処理を施した。

【0039】「比較例2」上述した実施例における「試

試験用ガスケットおよび試験用シートに高温熱処理を施さなかった。

【0040】「比較例3」上述した「比較例1」における試験用ガスケットおよび試験用シートに高温熱処理を施さなかった。

【0041】「比較例4」上述のように調製して得られた光硬化型液状ガスケット材料Bに「実施例」同様、親水性シリカを添加、混練した後、試験用ガスケットおよび試験用シートを成形し、高温熱処理を施した。

【0042】粘度試験

液状ガスケット材料を適当な容器に採り、B型回転粘度計にて25°Cにおける粘度を測定した。

【0043】吐出流量試験

内径1.43mmのノズルを取り付けたシリンジ(内径1.5mm、内容量10cc)に液状ガスケット材料を採り、0.03MPaの空気圧をかけたときの液状ガスケット材料(60°C)の吐出量を測定した。

【0044】硬さ試験

試験用シートにおいてJISK6253に従い、ゴム硬度を測定した。

【0045】引張試験

試験用シートにおいてJISK6251に従い、引張強さ、切断時伸びを測定した。

【0046】揮発ガス定量試験

試験用ガスケットにおいて、以下の方法で加熱時に揮発するガスの定量を行なった。ヘリウムバージの下、試験用ガスケットを110°Cで18時間加熱し、そのとき発生したガスを吸着剤に捕集した。捕集した発生ガスは動的ヘッドスペース法を用いたバージ&トラップ装置内で再捕集させ、その後GC-MS装置に導入して、定量分析を行なった。定量はn-テトラデカン換算にて実施した。

【0047】実施例および比較例1~4を上記の試験により評価した結果を図6に示す。

【0048】無機充填剤を添加し光硬化型液状ガスケット材料のチキソトロピー性を高めることで、吐出装置の吐出能力を損なわせず、かつ「高さ/幅比」の高いシール性能に理想的な形状のガスケットを得ることができた。また、ガスケットは高温熱処理を施すことで揮発ガス量を大幅に低減することができた。一方、一般式1および一般式2とは異なる構造の反応性希釈剤を使用した*

*「比較例4」では、紫外線硬化後のゴム硬度が高くなり、精密機器用ガスケットとしてのシール性能を充分に満たすには向きであった。

【0049】

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明に係る高チキソトロピー性を示す光硬化型液状ガスケット材料を、X-Y-Z軸塗布ロボットを用いて防塵カバー表面上に紐状に塗布することにより、効率良く高い生産性で、吐出した液状ガスケット材料の断面形状をガスケットのシール性能に理想的な断面形状に保持することができる。また紫外線等の活性エネルギー線を照射することにより塗布した液状ガスケット材料を硬化させて製造したガスケットは、ゴム中に含まれる揮発成分を除去するため、および基板との接着性を増加させるために高温熱処理を行う。これにより金属基板との接着性が高く、プライマー処理や接着剤が不要で、かつ揮発するガス量が極めて少ない低アウトガス性の精密機器用ガスケットの製造が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る精密機器用ガスケットの製造方法において用いるX-Y-Z軸塗布ロボットの概略正面図。

【図2】図1に示したX-Y-Z軸塗布ロボットの概略側面図。

【図3】図1および図2に示したX-Y-Z軸塗布ロボットを用いて基板表面上に液状ガスケット材料を吐出する状態を示す概略側面図。

【図4】基板表面上に吐出された液状ガスケット材料の配置を説明する概略斜視図。

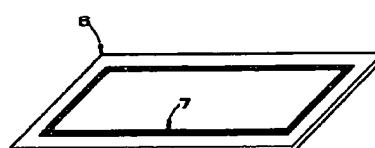
【図5】基板表面上に製造されたガスケットの断面図。

【図6】実施例の結果を示す表図。

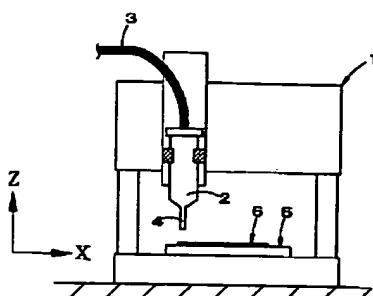
【符号の説明】

- 1 X-Y-Z軸塗布ロボット
- 2 ディスペンサ
- 3 圧力空気供給管
- 4 ノズル
- 5 水平テーブル
- 6 金属基板
- 7 液状ガスケット材料
- 8 ガスケット

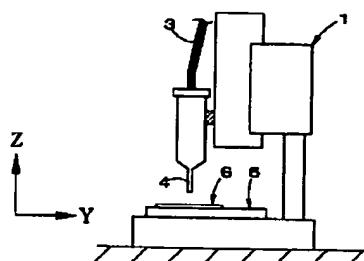
【図4】



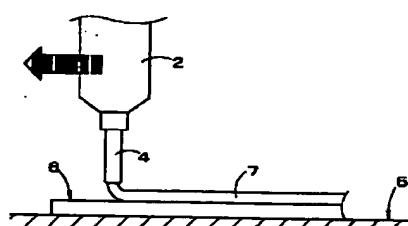
【図1】



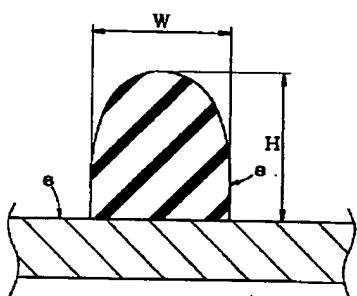
【図2】



【図3】



【図5】



【図6】

	実施例	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4
光硬化型液状材料	A	A	A	A	B
無機充填剤(添加…○, 未添加…×)	○	×	○	×	○
高温熟処理(実施…○, 未実施…×)	○	○	×	×	○
液状材料					
粘度(25°C) 回転数 2 rpm (mPa·s)	620,000	2,600	620,000	2,600	570,000
回転数 20 rpm (mPa·s)	89,000	2,500	89,000	2,500	78,000
吐出量(80°C) (g/min)	1.62	4.57	1.62	4.57	1.89
試験用シート					
硬度 (→)	A18	A9	A18	A8	A63
引張強さ (MPa)	0.81	0.39	0.79	0.41	1.81
切断時伸び (%)	125	165	140	175	85
試験用ガスケット					
形狀	平均高さ (mm)	1.00	0.48	1.00	0.48
	平均幅 (mm)	1.25	3.12	1.25	3.12
	高さ/幅比 (→)	0.80	0.15	0.80	0.15
	揮発ガス量 (μg/g kg)	28.0	20.9	3808.6	3711.8
					58.9

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F 16 J 15/14

識別記号

F I

F 16 J 15/14

マークド(参考)

C

F ターム(参考) 4H017 AA04 AA24 AB01 AB05 AB17
AC04 AC08 AC11 AC14 AC17
AC19 AD01 AE04
AJ027 AG03 AG27 AG28 AJ01 AJ02
AJ08 AJ09 BA07 BA19 BA20
CA11 CC03 CD09